

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Messerleiste gerade Bauform R/2,  
Art. Nr. 115-79056

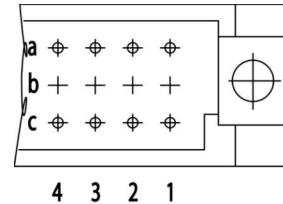
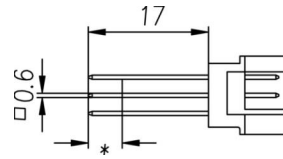
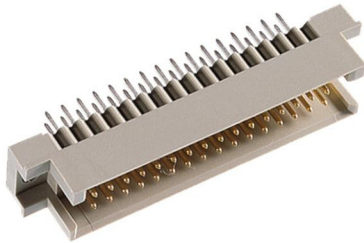


Abbildung ähnlich



Parallel



Rechtwinklig



Einpresstechnik



Rugged

- Anschlusslänge 17 mm
- mit Steckzone in Gütestufe 2
- Polzahl 32
- Einpresstechnik
- Gütestufe 2



» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe [DIN 41612](#)

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Messerleiste gerade Bauform R/2,  
Art. Nr. 115-79056



## Technische Daten

### Grundlagen

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Spezifikation        | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
| Gütestufe            | 2                       |
| Anzahl Kontakte      | 32                      |
| Anschlusstechnik     | Einpresstechnik         |
| Anschlusslänge       | 17 mm                   |
| Leiterplattenabstand | 16.85 mm                |
| Betriebstemperatur   | -55°C bis +125°C        |

### Material

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Isolierkörper                | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
| CTI Wert<br><i>IEC 60112</i> | 200                               |
| Kontaktmaterial              | Kupferlegierung                   |

### Mechanisch

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Rastermaß             | 2.54 mm         |
| Steckkraft            | < 30 N          |
| Ziehkraft pro Kontakt | > 0.15 N        |
| Lebensdauer           | 400 Steckzyklen |

### Elektrisch

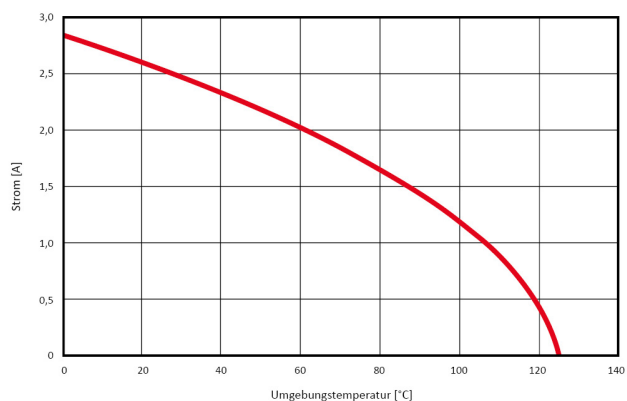
|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Betriebsstrom           | 2.6 A                |
| Durchgangswiderstand    | < 20 mΩ              |
| Luft- und Kriechstrecke | ≥ 1.2 mm             |
| Isolationswiderstand    | > 10 <sup>6</sup> MΩ |
| Prüfspannung            | 1000 V               |

### Zulassungen / Konformität

|         |              |
|---------|--------------|
| UL file | E130314      |
| Umwelt  | RoHS konform |

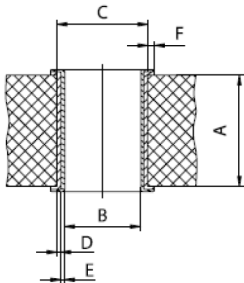
### Derating Diagramm

Stromtragfähigkeit DIN R (96-polig)  
max. 2.6A bei 20°C



### Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



| Material                    | chem. Sn Leiterplatten        |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Nennloch</b>             | <b>Ø 1.0 mm</b>               |
| <b>A Leiterplattendicke</b> | min 1.44 mm                   |
| <b>B Endloch</b>            | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm        |
| <b>C Grundbohrung</b>       | 1.15 ±0.025 mm                |
| <b>D Cu Schicht</b>         | min. 25 µm                    |
| <b>E Oberfläche</b>         | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| <b>F Restring</b>           | min. 0.1 mm                   |

| Material                    | Ni, Au Leiterplatten                                |
|-----------------------------|---|
| <b>Nennloch</b>             | <b>Ø 1.0 mm</b>                                     |
| <b>A Leiterplattendicke</b> | min 1.44 mm   |
| <b>B Endloch</b>            | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm                              |
| <b>C Grundbohrung</b>       | 1.15 ±0.025 mm                                      |
| <b>D Cu Schicht</b>         | min. 25 µm  |
| <b>E Oberfläche</b>         | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| <b>F Restring</b>           | min. 0.1 mm   |

| Material                    | rein Cu Leiterplatten                         |
|-----------------------------|---|
| <b>Nennloch</b>             | <b>Ø 1.0 mm</b>                               |
| <b>A Leiterplattendicke</b> | min 1.44 mm                                   |
| <b>B Endloch</b>            | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm                        |
| <b>C Grundbohrung</b>       | 1.15 ±0.025 mm                                |
| <b>D Cu Schicht</b>         | min. 25 µm                                    |
| <b>E Oberfläche</b>         | OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| <b>F Restring</b>           | min. 0.1 mm                                   |

| Material                    | HAL Sn Leiterplatten   |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Nennloch</b>             | <b>Ø 1.0 mm</b>        |
| <b>A Leiterplattendicke</b> | min 1.44 mm            |
| <b>B Endloch</b>            | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| <b>C Grundbohrung</b>       | 1.15 ±0.025 mm         |
| <b>D Cu Schicht</b>         | min. 25 µm             |
| <b>E Oberfläche</b>         | HAL Sn, 5 - 15 µm      |
| <b>F Restring</b>           | min. 0.1 mm            |

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Messerleiste gerade Bauform R/2,  
Art. Nr. 115-79056

---



## Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- Vor- und nachteilende Kontakte
- ohne Befestigungsflansch
- Sonderlänge
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderbestückung

## Zeichnungen

Die Kundenzeichnung zu diesem Produkt erhalten Sie auf Anfrage unter [sales@ept.de](mailto:sales@ept.de)